

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

(43)Date of publication of application: 14.06.1986

(51)Int.CI.

7/26 G11B

G11B 7/00

(21)Application number: 59-247736

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

22.11.1984

(72)Inventor: FUKAGAWA HIROSHI

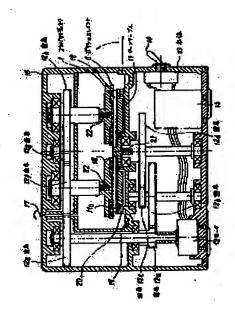
MOGAMI NAOMI ISHIWATARI AKIO

(54) FLAW ELIMINATING DEVICE OF OPTICAL DISC

(57)Abstract:

PURPOSE: To read accurately recorded signals in the state where an optical disc has no flaws, by rotating a polishing member relatively to the surface of the optical disc and polishing the surface of the optical disc to eliminate flaws.

CONSTITUTION: An upper case 16 is opened, and a compact disc 1 is placed on a turntable 11 so that the surface of flaws is turned up, and the case 16 is closed, and a polishing element 6 is brought into contact with this surface, and a power switch 14 is turned on to rotate a motor 13 for a certain time. The rotation of the motor 13 is trnasmitted by gears 12aW12g to rotate the table 11 and the element 6 of a polish plate 18. By this rotation, the element 6 itself is rotated, and the table 11 is rotated to rotate the disc 1, and the polishing element polishes all of the surface of the disc 1. Thus, flaws on the disc 1 are eliminated, and recorded signals are read out accurately in this state.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

Best Available Copy

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-126647

@Int_Cl_4

触別記号

庁内整理番号

昭和61年(1986)6月14日 ❸公開

G 11 B

7/26 7/00

8421 — 5D — 7734 — 5D

未請求 発明の数 1 (全4頁) 審查請求

光学ディスクの傷除去装置 の発明の名称

> 頭 昭59-247736 の特

> > 博

昭59(1984)11月22日 223出

JII 明 老 深 砂発

·上 尚 己 東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社内

明 者 菣 70発

東京都品川区北品川6丁目7番35号 東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社内

者 勿発 明

渡

昭 夫

東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社内

ソニー株式会社 仍出 願 人

外1名

弁理士 伊藤 多代 理

光学ディスクの傷除去袋屋 発明の名称

券許請求の範囲

光学ディスタが載置可能をテープルと、眩テー ナル上の光学アイスタの表面と当接しながら相対 的に回転移動する研磨素子とを有し、該研磨素子 の上記光学ディスク表面の相対的な国転移動によ り上記光学ディスクの傷の研磨をするととを特徴 とする光学ディスクの傷除去装置。

祭明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光の反射により信号の読み出しを行 なうコンパクトティスクヤビデオティスク等の光 学ディスクの傷除去装置に関する。

(従来の技術)

光の反射により信号の読み出しを行なうコンパ クトティスクヤビアオテイスク等の光学デイスク が近年実用化されている。第5回は、これらの光 学アイスクの何としてコンパクトディスクの所面 を示した図で、コンパクトデイスク(1)は、ポリカ

ーポネイト樹脂等の透明な合成樹脂より基体(2)が なり、この基体(2)の片面が凹凸状になつて信号が 配録されている。との基体(2)の信号が配録された 面上には反射層(3)が形成され、さらにその上から ラペル等の保護体(4)が貼付けられている。とのよ うに構成されて、基体(2)の信号が配象されていた い面から光を照射して、反射層(3)から反射された 光を読み取つた後、光・電気変換器により電気信 号に変換して信号の読み出しを行なう。

ととで、 基体(2)の 表面(5) に 傷が付いた 際 には、 その傷の状態により誤つて信号が読み出される場 合がある。即ち、傷により基体(2)への信号読み取 り光の入射・出射の変化が、正しく読み取れない 稳度になつている場合には、読み出し信号の誤り 中欠落を生じ、最悪の場合にはディスクが使用不 飽となる。

との為に従来は、再生装置の信号読み出し回路 に何らかの補償回路を設けて、脱み出し信号の誤 りゃ欠落が生じた際には前後の信号等から正しい 信号の推測を行なつて補償していた。

特開昭61-126647 (2)

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、上記した補債回路による補債に は前後の信号等からの推測のため限定があり、完 全な補債を常にしているとは補債が不能となたこ の傷が広範囲に互るときには補償が不能となる不 都合があつた。本発明はこれらの点に競み、傷が 表面に発生して信号が正しく読み取れなくなつた 光学ディスクの誤り或いは欠落信号の には行なわれない問題点を解決することにある。 (問題点を解決するための手段)

上記した同区点を解決するために、本発明の光学ディスクの傷除去装置は、光学ディスク(1)が数量可能なテーアル(1)と、このテーブル(1)上の光学ディスク(1)の表面と当接しながら相対的に回転移動する研磨素子(2)とを有し、研磨素子(2)の光学ディスク(1)を面の相対的な回転移動により光学ディスク(1)の傷の研磨をするものである。

斯る、本発明の光学デイスクの傷除去装置によれば、研磨索子四が光学デイスク(1) 表面を相対的

上方の上ケース的は、本体似とは衆番切を介して 連結されて開閉目在である。上ケース傾の上側内 節には歯車 (121),(12g),(12h)が収められて、上ケ ース好を閉じた状態の際に、本体似質のモータの の出力軸と同一軸上に取付けられた歯草(12a)と 上ケース66側の歯車(121)とが戦合する。さらに上 ケース(6)には、 歯車 (12f) と歯車 (12h)との 同一 曲 上にそれぞれポリシュプレート好が螺子切による ねじ止めで取付けられ、との両ポリシュアレート 48は先備面が上ケース的を閉じた際に前配ターン テーナル臼とコンパクトテイスク(1)の厚さ以下の わずかな隙間をあけて対向する位置にある。ポリ シュプレート08の先端面には円盤状のポリシュエ レメント(6) が装焙可能である。たね、モータ(4)の 回転は本体似内の電気制御部は及び本体如外面の ペワースイッチO4により制御され、ペワースイツ チロをオンにすると一定時間モータロが回転する 構成である。そしてモータ料が回転すると、各歯 車により伝動されて、ターンテーアル印及びポリ シュプレート(明が回転する。

に回転移動することにより光学アイスク(1)表面を研磨して、光学アイスク(1) 表面に発生した傷を除去するので、光学アイスク(1) は傷がない状態となり配録された信号を正確に読み出せる。

〔吳施贺〕

以下、本発明の光学ディスクの傷除去装置の一 実施例を、第1図乃至第4図を参照して説明しよう。

第1回は、光学アイスクの傷除去装置全体の桜断面図である。との傷除去装置の本体的の中央部には、光学アイスク(1)が数置可能なターンテーアルのが関係でなかつ蝶子的により着脱目をに配置されている。ターンテーアルの裏面には溝(11a)が外周に沿って全局にわたつで設けられて、本体的側にはとの溝(11a)と遊安する。突のターンテーアル的は、本体的内に固定されたモータはから歯取(12a)、(12b)、(12c)、(12d)を介して駆動されて回転する。ターンテーアルのの

次に、オリシュプレート傾の先端面に取付けられるポリシュエレメント(6)の構造を説明する。第2回は、ポリシュエレメント(6)の機断面図で、全体は中空の円盤状をして、サンドを持ちます。の4 解析で構成フェルト(9)、両面接着テープ(8)の4 解析で構成リシスト(6)をポリシュエレンとの先端面に接着テープ(8)により接着する。ととアイスク、例えばコンパクトアイスク(1)をターンナーアル似上に収せた時により、所定をパンナーフル似上に収せた時に、コンパクトアイスク(1)の表面にポリシュエレメント(6)の厚さにカウ、カナーフル以上に収せた時に、コンパクトアイスク(1)の表面にポリシュエレメント(6)のアイスクの対上に収せた時に、コンパクトアイスク(1)の英面にポリシュエレスのの大きさである。

本実施例の光学ディスクの傷除去装置は以上の

ように構成され、以下その動作を説明する。

まず、上ケース頃を開けてからターンテーアル は1)上に傷を除去する必要のあるコンペクトディス クは等の光学ディスクを載せる。この時、傷のあ

る面、即ち基体(2)の要面(5)が上面になるようにす そして、上ケース何を閉じてコンペクトデイ スク(1)の表面(5)にポリシュエレメント(6)の研磨素 子四を当接させる。この状態で、パワースイッチ・ OIをオンにしてモータ内を一定時間回転させる。 モータロが回転すると各歯車:(12m)~(12g)により 伝動してターンテープル(対及びポリシュプレート 個に取付けられたポリシュエレメント(6)が回転す る。との回転により、ポリンユエレメント(6) 自身 が囲転したがらメーンテーアル印も回転するので、 コンパクトデイスク(1)は回転移動し、研磨素子の がコンペクトティスク(I)の表面(5)の全面を研磨す る。 第 3 図は、コンペクトディスク(1)の表面(5)上 をポリシュエレメント(8) が回転する様子を示した 図で、図示のようにおりシュエレメント(6)とコン ペクトディスク(1)の双方が囲転する。

以上のようにして回転してコンパクトデイスク(1)の要面(5)を研磨することにより、要面(5)が平滑さを保ちながら削り取られ、傷の深さまで削ることにより傷を除去することが出来る。なお、本実

に本実施例では、歯車 (12m)と(12b)及び(12c)と(12d) との被速比を大きくして、ターンテーテル何の値 転速度を落としている。

以上の説明では、本発明の傷除去装置を傷除去 に使用した場合について説明したが、ポリシュエ レメントを交換することにより、光学デイスクの 表面の符れとりを行えうことも出来る。第4回は、 丹れとりを行たう場合のポリシュエレメント(6) を示した図で、研磨用のポリシュエレメント(6)に 比べて研磨素子四がなく、その分だけフェル 1493 の厚さを厚くしてある。とのポリシュエレメント (6)を前記したポリシュエレメント(6)が取付けら れたオリシュプレート姆とは別のオリシュプレー トOBに予め取付けてかき、ポリシュプレートOBと と交換する。そして、とのポリシュエレメン ト(6つ のフェルト(9)が光学アイスクの表面を磨き、汚 れを除去する。この時間には、フェルト(9)にク リーニング液等を含ませることにより、汚れ除去 の効果が増す。なお、この汚れとりは前配した研 磨作業の前後に行なうことで研磨が効率よく行な

施例では一定時間後にモータ間の回転が止まる様 にたつているので、一定の作動で削り取る厚さが 不足している時には、再度モータ母を回転させれ はよい。但し、削り取れる最大の厚さは、前配基 体(2) ガティスクの強度を維持出来る程度までで、 例えばコンパクトテイスクの場合には0.5=現底が 最大の削り取れる厚さである。以上のようにして ディスク(1)を削り取ると、削り残渣が発生するが、 チーンテーナル(1) 裏面外周沿いの溝 (11d)と本体(4) 側の突条例とにより、ターンテーブル印裏間への 削り残渣の浸入が防がれると共に、外間に沿つた 得時に削り残渣が集められる。さらに万一ターン テープル伽の裏面に削り残隆が浸入した場合には、 線子切によりメーンテーブル付を取り外せば削り **残渣の掃除を容易に行なうことが出来る。また研** 磨する際には、基体②は合成樹脂より出来ている ので、ターンテーナル匈及びオリシユエレメント (6)の餌転速度を速くしすきると、研磨するときの 発熱でディスクが変形する恐れがあり、熱変形し ない程度の回転速度を選ぶ必要がある。とのため

えるし、研磨作業を行なう際に2枚のポリシュプレート(4)の内、一方を研磨素子(2)の付いたポリシュエレメント(6)に、他方をフェルト(9)の付いたポリシュエレメント(6)にすることで、削り残渣や行れ等を除去しながら研磨することも出来る。

なか、光学アイスクの例としてコンパクトデイスクの場合について説明したが、光学方式のビデオアイスク等、他の光学アイスクの場合にも上述の傷除去装置を適用することが出来る。また本発明は上述実施例に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、その他種々の構成が取り得る。

〔発明の効果〕

The Allegar Control of Section 1880, 1884.

本発明による光学ディスクの傷除去装置によると、光学ディスクが軟置可能なテーブルと、このテーブル上の光学ディスクの表面と当接したがら相対的に回転移動する研磨素子とを有することにより、研磨部材の光学ディスク表面の相対的な回転移動で光学ディスク表面を研磨して、光学ディスク表面に発生した傷を除去するので、光学ディスクは本発明の傷除去装置を使用することにより

傷がない状態となり、再生装置の補償回路を使用することなく正確な信号の読み出しが可能となるし、補償回路により信号の補償が行なえないほどの傷があつた場合にも本発明の傷除去装置を使用することで傷のない状態とすることができ、正確な信号の読み出しが可能となる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の光学ディスクの傷除去装置の一実施例を示す断面図、第2図は研磨用ポリシュエレメントの一例を示す断面図、第3図は研磨動作の説明に供する平面図、第4図は汚れ除去用ポリシュエレメントの一例を示す断面図、第5図はコンペクトディスクの一例を示す断面図である。

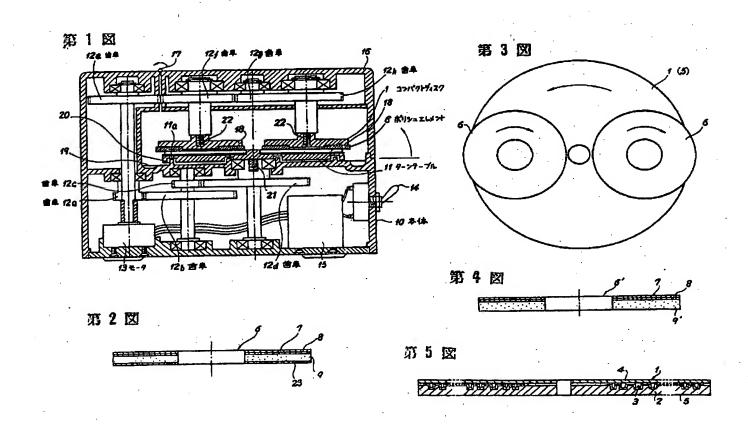
(1)はコンパクトテイスク、(6)はポリシュエレメント、似は本体、(1)はターンテーテル、(12a)、(12b), (12c), (12d), (12e), (12f) 及び(12g) は歯取(はモータ、(2)は研磨素子である。

代·理 人

伊藤

FRT





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

⋈ BLACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ OTHER.	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.